



RE900-03

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP I 20, 24 (0,50 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 16,73 x 30,94 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00